Zum Klienten:
Weitere Informationen zum Klienten und laufend neue Jobchancen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung und dem Onboarding durch Ihren Fachberater per Mail oder online. Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen!

Arbeitsort:
Zürich (X Kilometer und X Minuten von Ihrer Wohnadresse entfernt)

Jobbeschreibung:
RF & Photonics Packaging Engineer (w/m/d)

Ihr Aufgabengebiet:
- Verantwortung für die Entwicklung von Packaging-Technologien, Chip-Assemblies sowie Supply-Chain-Management
- Enge Zusammenarbeit mit internen R&D-Teams (Design, PDK, Prozessentwicklung, Charakterisierung, Test), um 'Design for Packaging' und 'Design for Testing' sicherzustellen
- Identifikation und Implementierung verschiedener Packaging-Konzepte kompatibel mit der TFLN-Technologie (z. B. Laser-Integration, Treiber- und TIA-Integration, Wire Bonding, Fiber Attachment)
- Simulation relevanter Packaging-Konzepte in modernen elektromagnetischen Simulationstools (COMSOL, HFSS, ADS etc.)
- Entwicklung von Fiber-to-Chip-Koppellösungen, Spot Size Convertern und Anbringung von Fiber Array Units (FAUs)
- Sicherstellung einer Multi-Sourcing-Strategie für alle identifizierten Packaging-Konzepte inkl. elektrischer und optischer Fiber-Attach-Verfahren
- Diversifizierung der Lieferkette mit westlichen, europäischen und asiatischen Lieferanten
- Projektmanagement interner R&D-Projekte, öffentlich geförderter Projekte sowie Kunden-Assembly-Projekte mit externen Partnern wie Assembly Houses und OSATs
- Hauptansprechperson und Beziehungsmanagement zu Packaging Houses und OSATs
- Definition von Packaging-Spezifikationen, Budget und Zeitplan für Subunternehmer
- Sicherstellung termingerechter, spezifikationskonformer und budgetgerechter Lieferung der Assemblies
- Koordination mit dem R&D-Team bezüglich Testing, Charakterisierung und Qualifizierung auf Package-Ebene
- Identifikation und Implementierung passender Assembly-Technologien basierend auf Kundenanforderungen
- Definition von Qualifizierungsplänen und -verfahren für Packaging-Konzepte sowie Durchführung von Zuverlässigkeits- und elektrischen Stresstests
- Unterstützung bei RMA-Fällen in Bezug auf Assembly-Themen
- Enge Zusammenarbeit mit R&D-Teams von Design bis optischer Testung und Charakterisierung
- Gelegentliche Reisen zu Assembly-Partnern und OSATs
- Teilnahme an öffentlich geförderten Projekten (HorizonEurope, InnoSuisse, European Chips Act etc.)
- Pflege umfassender Dokumentation, Reporting sowie Erstellung von Standard-Arbeitsanweisungen und Schulung neuer Kolleginnen und Kollegen
- Verfolgung aktueller Entwicklungen in der Photonik und Einbringung neuer Techniken ins R&D-Umfeld

- Identifikation von Packaging-IP und Beitrag zum IP-Portfolio unseres Unternehmens

Was Sie ausmacht:

- Abgeschlossenes Studium (Master/PhD) in Elektrotechnik, Physik, Elektro-Optik, Wireless Communications, Integrierter Photonik, Chemie, Materialwissenschaften oder einem verwandten Fachgebiet
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nach dem Studium im Bereich Elektronik, Photonik, elektronisches Packaging, PCB-Fertigung, Materialwissenschaften oder RF-Design
- Nachweisbare Erfahrung in der Überführung elektro-optischer Assemblies vom Konzept über den Prototyp bis zur Serienproduktion
- Erfahrung mit photonischen Packaging-Konzepten, Fiber Attach, elektronischen Redistribution Layers (RDLs), Under-Bump-Metallisierung (UBM), Bumping, Kupfersäulen oder anisotrop leitfähigem Klebstoff (ACF) von Vorteil
- Erfahrung mit RF-Simulationstools (COMSOL, Keysight ADS, Ansys, HFSS, CST) von klarem Vorteil
- Erfahrung mit intermetallischen Phasen und SEM-EDX von Vorteil
- Ausgeprägte Organisationsfähigkeit, exzellentes Projektmanagement und hohe Detailgenauigkeit
- Erfahrung im Umgang mit und der Dokumentation von RMA-Prozessen sowie in der Kommunikation mit internationalen Lieferanten und Subunternehmern
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in einem multidisziplinären Team und mit internationalen Kunden
- Interkulturelle Sensibilität und Anpassungsfähigkeit der Kommunikation an US-amerikanische, europäische und asiatische Partner
- Erfahrung im internationalen Lieferanten- und Vendor-Management
- Fähigkeit, in einem schnelllebigen Startup-Umfeld flexibel und belastbar zu agieren
- Bereitschaft zu internationalen Reisen bis zu 20 %
- Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Deutsch- oder Asiensprachenkenntnisse von Vorteil

Was diese Stelle ausmacht:

- Einzigartige Gelegenheit, eine zukunftsweisende Fertigungsinitiative im stark wachsenden Bereich der Photonik zu leiten
- Attraktive Vergütung inkl. Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP)
- Schlüsselrolle in einem jungen, motivierten und energiegeladenen Startup-Team mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten